

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：黃澤淵

電話：02-2771-2171#6023

電子信箱：receivable0308@ntut.edu.tw

受文者：國立臺中教育大學

發文日期：中華民國115年8月24日

發文字號：北科大產學字第1157900240號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：海報、課程表 (115F900678_1_24094217019.png、115F900678_2_24094217019.pdf)

主旨：檢送本校與實威國際股份有限公司合作辦理115年「以AI
輔助為核心之SOLIDWORKS半導體散熱設計與熱流分析實
務」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參
加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、隨著半導體製程、AI 晶片與高效能運算（HPC）技術快速發展，晶片功耗與熱密度持續攀升，散熱問題已從單一元件層級，擴展至模組、伺服器與系統層級，成為影響產品可靠度與效能的關鍵因素。包含半導體產業的設備供應商，以及AI伺服器與資料中心建置的供應商，大多使用SOLIDWORKS 3D軟體進行設計。在此趨勢與現況下，著重於機構結構與外型設計的 3D 設計教學，已難以滿足半導體設備產業對工程人才的實際需求。設計工程師必須熟悉3D建模的技能，並且在設計初期，即具備基本的結構與熱流分析與散熱驗證能力。課程旨在讓半導體領域學程的同學們了解SOLIDWORKS在散熱問題上可能提供的解決方案，並

鼓勵學生使用SOLIDWORKS產品線，了解產業相關設備在機構設計與驗證分析的垂直整合方式。

二、報名資格：全國各大專校院在學學生。

三、課程時間：115年8月26日（三）、8月27日（四）、8月28日（五），共計3天，符合報名資格，且參與全程課程者，將於課程結束後由合作企業核發研習時數證明（電子檔）。

四、課程地點：國立臺北科技大學綜合科館電機系511教室（臺北市大安區忠孝東路三段1號）、Google Meet線上課程。

五、人數上限：實體40人/線上200人。（課程免費）

六、報名時間：即日起至115年8月20日（四）17點為止（如人數額滿將提前截止）。

七、報名網址：<https://forms.gle/nbSZVkBHH4n5YWE58>

八、課程聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6023，電子郵件：receivable0308@mail.ntut.edu.tw、鄭經理，連絡電話：(02)2771-2171分機6012，電子郵件：clcheng@mail.ntut.edu.tw。

九、協辦單位：實威國際股份有限公司。

十、檢附課程表及宣傳海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學合作處

